深圳精智达技术股份有限公司 关于自愿性披露半导体测试设备研发进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称"公司")半导体成品测试(Final Test, 以下简称"FT")设备(以下简称"该产品""FT测试机")研发和生产 取得重大成果。为便于广大投资者了解公司该产品及其进展情况,现将其情况披 露如下:

一、产品情况及讲展

FT 测试机主要应用于芯片完成封装后,对封装完成后的芯片进行功能和电 参数测试。

基于公司及控股、参股公司长期技术积累,公司研发的 FT 测试机 2024 年 度内取得重大进展。该产品使用专用 ASIC 芯片,最高可实现 9Gbps 信号输出与 校准,系统通道数量为国外同类产品的 1.5 倍,可应用于 DDR4、DDR5、LPDDR4、 LPDDR5 等芯片成品测试。该产品已完成公司内部测试,测试结果均达到设计要 求。

截至本公告日,本公司已向客户提供该产品样机进行验证。

二、对公司的影响

该产品丰富公司半导体测试设备产品线,提升公司市场竞争力,促进公司经 营持续、健康、稳定发展,并助力本土产业加速升级及产业链安全保障。未来, 公司将继续加大针对半导体设备的技术投入,为客户提供更多品类及更优质产品。

三、风险提示

该产品研发取得重大进展到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程,目前主要客户尚未完成最终验证工作,且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致产品效益不及预期的风险,对公司收入及盈利的影响尚存在不确定性。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会 2025年1月6日